

令和 03 年度 (後期) 技能検定 学科試験正解

半導体製品製造 / 集積回路組立て作業【2級】

真偽法

番号	1	2	3	4	5
正解	○	×	○	○	×

番号	6	7	8	9	10
正解	×	○	○	×	○

番号	11	12	13	14	15
正解	×	○	○	×	○

番号	16	17	18	19	20
正解	×	○	×	○	×

番号	21	22	23	24	25
正解	○	×	×	×	○

択一法

番号	1	2	3	4	5
正解	ニ	イ	イ	イ	ハ

番号	6	7	8	9	10
正解	イ	ニ	ハ	□	□

番号	11	12	13	14	15
正解	ハ	ニ	□	□	ハ

番号	16	17	18	19	20
正解	ニ	ニ	ハ	□	ハ

番号	21	22	23	24	25
正解	イ	□	ハ	ニ	イ